

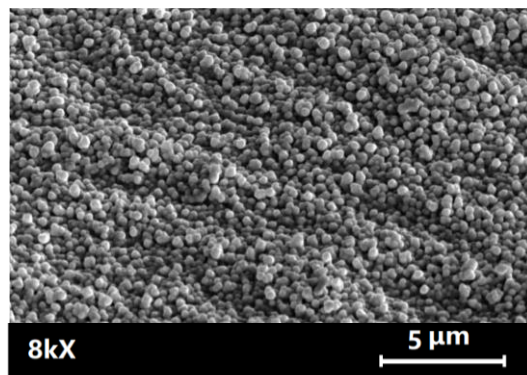
## 典型应用

- ★ BT/类BT
- ★ IC 封装基板
- ★ 高密度互联板

## 典型特征

- ★ 超薄
- ★ 低粗糙度
- ★ 压合后可分离

## 典型技术指标



项目		单位	性能参数		测试方法
标称厚度		μm	2	3	IPC-4562A
单位面积质量		g/m <sup>2</sup>	24	33	IPC-TM-650 2.2.12
薄铜粗糙度Rz	处理面	μm	2.0	2.0	IPC-TM-650 2.2.17
	非处理面		1.5	1.5	
分离力	BT	N/mm	0.01	0.01	IPC-TM-650 2.4.8.4
剥离强度	BT	lb/in	3.0	3.0	IPC-TM-650 2.4.8

★ 以上数据为典型值，非保证值。

★ 半固化片会影响剥离强度，铜箔使用前请进行半固化片匹配实验或咨询德福科技技术服务人员。上述超薄铜箔剥离强度测试，是加厚到35μm后的测试结果。

网站: [www.jjdefu.com](http://www.jjdefu.com)

电话(传真) : 0792-8252044

地址: 江西省九江市汽车工业园顺意路15号

